

DERWENT-ACC-NO: 1998-274587
DERWENT-WEEK: 199911
COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Printed circuit board device - has integral cooling
plate with
incorporate d cooling channels for dissipating waste heat
generated by circuit
board components

INVENTOR: ILGEN, H; SCHUETZE, J ; SUELLAU, W

PATENT-ASSIGNEE: ILFA INDUSTRIELEKTRONIK & LEITERPLATTEN
[ILFAN]

PRIORITY-DATA: 1996DE-1047916 (November 20, 1996)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO	PUB-DATE	LANGUAGE
PAGES	MAIN-IPC	
DE 19647916 C2	February 18, 1999	N/A
000	H05K 007/20	
EP 844808 A2	May 27, 1998	G
008	H05K 001/02	
DE 19647916 A1	May 28, 1998	N/A
000	H05K 007/20	

DESIGNATED-STATES: AL AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT
LI LT LU LV MC MK NL P
T RO SE SI

CITED-DOCUMENTS: No-SR.Pub

APPLICATION-DATA:

PUB-NO	APPL-DESCRIPTOR	APPL-NO
APPL-DATE		
DE19647916C2	N/A	1996DE-1047916
November 20, 1996		
EP 844808A2	N/A	1997EP-0120236
November 19, 1997		
DE19647916A1	N/A	1996DE-1047916
November 20, 1996		

INT-CL_(IPC): H05K001/02; H05K007/20
ABSTRACTED-PUB-NO: EP 844808A

BASIC-ABSTRACT:

The device has at least 2 printed circuit boards supporting heat generating components, with a cooling plate (18) incorporating cooling channels (24) forming an integral part of the device.

The cooling plate has a carrier layer (26) supporting a heat conductive cooling layer (22) incorporating the open cooling channels, covered by an insulating plate (20) applied to the cooling plate.

USE - For miniaturised printed circuit board device.

ADVANTAGE - Effective heat dissipation for preventing overheating damage to circuit board components.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.2/2

DERWENT-CLASS: V04

EPI-CODES: V04-Q05; V04-T03;

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 844 808 A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:

27.05.1998 Patentblatt 1998/22

(51) Int. Cl.⁶: H05K 1/02, H05K 7/20

(21) Anmeldenummer: 97120236.1

(22) Anmeldetag: 19.11.1997

(84) Benannte Vertragsstaaten:

AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC
NL PT SE

Benannte Erstreckungsstaaten:

AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 20.11.1996 DE 19647916

(71) Anmelder:

ILFA Industrieelektronik und
Leiterplattenfertigung aller Art GmbH
30559 Hannover (DE)

(72) Erfinder:

- Süllau, Walter
38100 Braunschweig (DE)
- Ilgen, Hermann
01738 Dorfheim (DE)
- Schütze, Jörg
01738 Dorfheim (DE)

(74) Vertreter:

Patentanwälte Thömen & Körner
Zeppelinstrasse 5
30175 Hannover (DE)

(54) Leiterplattenanordnung

(57) Eine Leiterplattenanordnung mit mindestens zwei Leiterplatten, die mit elektrischen Leiterbahnen versehen und mit Wärme erzeugenden Bauelementen bestückt sind, umfaßt als integrierten Bestandteil der Leiterplattenanordnung eine Kühlplatte (18) die mit Kühlkanälen (24) versehen ist. Die Kühlplatte umfaßt eine auf einer Trägerschicht (26) angeordnete wärmeleitende KÜHLSCHICHT (22), wobei die Kühlkanäle als einseitig offene Kanäle in der KÜHLSCHICHT verlaufen und durch eine zur Kühlplatte gehörende Isolierplatte (20) abgedeckt sind.

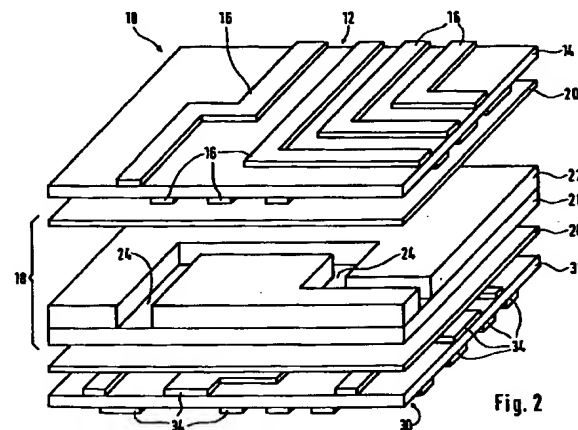


Fig. 2

EP 0 844 808 A2

Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Leiterplattenanordnung gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

In ihrer einfachsten Ausführungsform umfassen 5 Leiterplattenanordnungen eine Leiterplatte, die in gedruckter Schaltungstechnik auf ihrer einen Seite mit elektrischen Leiterbahnen versehen ist. Auf der Bestückungsseite einer solchen Leiterplatte werden die Bauelemente angeordnet, und die andere Seite der 10 Leiterplatte ist die Lötseite zur Befestigung der Bauelemente und zum Herstellen der erforderlichen elektrischen Verbindungen zwischen den Bauelementen.

In den meisten Fällen werden jedoch bei einer Leiterplattenanordnung mehrere übereinander angeordnete 15 Leiterplatten verwendet, die einseitig oder beidseitig mit elektrischen Leiterbahnen versehen sind und einen sogenannten Multi-Layer bilden. Dabei befinden sich zwischen den einzelnen Leiterplatten Isolierplatten, die in der Fachsprache als Prepreg bezeichnet 20 werden und üblicherweise aus einem in Harz getränktem Glasseidengewebe bestehen (FR4-Material). Der Zweck eines solchen Prepregs besteht darin, elektrische Kurzschlüsse zwischen den einzelnen Leiterplatten zu verhindern, und die Leiterplatten miteinander zu 25 verbinden, um einen Multi-Layer als eine Einheit zu erhalten.

Die auf einer Leiterplattenanordnung befindlichen elektrischen Bauelemente erzeugen im Betrieb Wärme, so daß es erforderlich ist, eine Kühlung vorzusehen, um 30 die Bauelemente vor einer Zerstörung zu schützen und um einen ordnungsgemäßen Betrieb der gesamten elektrischen Schaltung zu ermöglichen. Dieses gilt insbesondere dann, wenn sich auf der Leiterplattenanordnung Leistungsbaulemente befinden, die besonders 35 viel Wärme erzeugen.

Eine bekannte Maßnahme für die Kühlung besteht in der Verwendung eines Kühlkörpers, der mit dem Wärme erzeugenden Bauelement verbunden ist und in vielen Fällen Kühlrippen besitzt, um insgesamt eine 40 große kühlende Oberfläche zu erhalten, welche die Wärme an die Umgebungsluft abgeben kann. Diese Art der Kühlung ist jedoch sehr aufwendig und außerdem nicht besonders wirksam. Die Kühlkörper müssen an die betreffenden Bauelemente angepaßt werden und beanspruchen weitaus mehr Platz als das betreffende Bauelement selbst. Durch die ständige Wärmeabgabe 45 des Kühlkörpers erhöht sich ferner die Temperatur der Umgebungsluft selbst, wodurch der Wirkungsgrad einer solchen passiven Kühlung schlechter wird. Der große Platzbedarf der bekannten Kühlkörper mit Kühlrippen steht im übrigen dem mit der Verwendung von gedruckten Leiterplatten angestrebten Ziel einer Miniturisierung der gesamten Schaltungsanordnung entgegen.

Durch die europäische Patentschrift EP 0 590 354 B1 ist eine Anordnung mit einer Leiterplatte, mindestens einem Leistungsbaulement und einem Kühlkörper bekannt, bei welcher die in dem

Leistungsbaulement erzeugte Wärme und Verlustleistung potentialfrei an den Kühlkörper abgeführt werden kann. Dabei sind dem Leistungsbaulement auf beiden 5 Seiten einer Leiterplatte großflächige Leiterbahnen zugeordnet, die über Durchkontaktierungen wärmeleitend miteinander verbunden sind. Zwischen der unteren großflächigen Leiterbahn und dem Kühlkörper ist eine aus Kupfer bestehende Metallschicht angeordnet, und zur potentialmäßigen Trennung des Leistungsbaulements von dem Kühlkörper ist zwischen der unteren 10 großflächigen Leiterbahn und der Metallschicht aus Kupfer eine Glasgewebeschicht vorgesehen.

Auch diese bekannte passive Kühlung setzt einen im Vergleich zum Leistungsbaulement um ein Vielfaches größeren Kühlkörper voraus, wobei zur potentialfreien Abführung der Wärme an den Kühlkörper noch die beschriebene Glasgewebeschicht sowie die Metallschicht erforderlich sind.

Durch das deutsche Gebrauchsmuster G 93 20 574.0 ist eine Anordnung zum verbessern des Wärmeüberganges zwischen einem elektrischen Bauelement und einer Wärmesenke bekannt, bei welcher eine dicke Kühlplatte auf der Bestückungsseite einer Leiterplatte angeordnet wird. Die Leiterplatte mit den darauf befindlichen Bauelementen wird durch die Einwirkung der 25 Kraft einer Vielzahl von Federn gegen die Kühlplatte gedrückt, und auf den Bauelementen sind beidseitig beschichtete Keramikplatten angeordnet. Durch die Federn werden somit die Oberflächen der elektrischen Bauelemente auf die eine Beschichtung der Keramikplatte gedrückt, die ihrerseits mit der anderen Beschichtung auf die Kühlplatte gedrückt wird, wodurch der Wärmeübergang von den elektrischen Bauelementen auf die Kühlplatte erfolgt. Die Kühlplatte besitzt in ihrem 30 Innern ein Rohrsystem für ein Kühlmittel.

Der Aufbau der bekannten Anordnung ist wegen der benötigten Federn und der beidseitig beschichteten Keramikplatten sehr aufwendig. Sie kann außerdem nur bei einer Leiterplatte angewendet werden. Zur Kühlung 40 einer Leiterplattenanordnung mit mehreren ein- oder beidseitig bedruckten Leiterplatten (Multi-Layer) ist die Anordnung nicht geeignet.

In dem Dokument US 4 718 163 ist ein Verfahren zur Herstellung einer Kühleinrichtung zur Kühlung von 45 Leiterplatten beschrieben. Die bekannte Kühleinrichtung besteht aus einer Kupferplatte, die über ihren Querschnitt verteilt eine Vielzahl nebeneinander liegender Kanäle aufweist. Sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite der Kühleinrichtung läßt sich jeweils eine Leiterplatte anordnen. Da die Oberflächen der Kühleinrichtung durch Metall gebildet sind, ist es erforderlich, sowohl die Bauelemente als auch die elektrischen Verbindungen jeweils auf der der Metalloberfläche gegenüberliegenden Seite der Leiterplatte anzuordnen, die 50 deshalb nur einseitig bestückt werden können.

Für den Fall, daß die Herstellung elektrischer Kontakte von der einen zur anderen Leiterplatte erforderlich ist, wird in der US-PS 4 718 163 eine gesonderte Kühl-

einrichtung beschrieben, die so hergestellt wird, daß zwischen benachbarten Kanälen jeweils eine gleich große Aussparung vorhanden ist. Gleichwohl können auch in diesem Fall die beiden Leiterplatten nur einseitig bestückt werden. Im übrigen ist das Verfahren zur Herstellung der bekannten Kühleinrichtungen aufwendig, denn es muß ein Grundkörper aus Wachs hergestellt werden, in welchen zunächst Kupfer-Trennwände eingebracht werden. Anschließend wird dieser Körper vollständig mit einer Kupferschicht überzogen. Danach wird die Kupferschicht an zwei gegenüberliegenden Seiten wieder entfernt und in einem letzten Schritt wird der Wachs entfernt, so daß dann die Kanäle der Kühleinrichtung übrig bleiben.

Schließlich ist durch das Dokument US 4 706 164 eine aus mehreren Platten bestehende Anordnung bekannt, bei welcher zur Kühlung einer gedruckten Schaltung, die auch als Multi-Layer ausgebildet sein kann, eine Kühlplatte als unterste Platte der Anordnung vorgesehen ist, während die Leiterplatte die oberste Platte bildet.

In der Kühlplatte befinden sich Kühlkanäle, die mittels einer Dichtungsplatte abgedichtet sind. An diese Dichtungsplatte schließt sich zur mechanischen Stabilisierung der gesamten Anordnung eine Stabilisierplatte aus Metall an, und auf die Stabilisierplatte ist eine Isolierplatte gelegt, auf der sich wiederum die Leiterplatte befindet. Die gesamte Leiterplattenanordnung wird mechanisch durch Schraubverbindungen zusammengehalten. Auch diese bekannte Anordnung erfordert einen großen Aufwand. Nachteilig ist ferner, daß die Kühlplatte relativ weit von der Wärmequelle entfernt ist.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Leiterplattenanordnung zu schaffen, bei welcher eine Kühlung mit einem entscheidend verbesserten Wirkungsgrad erzielt wird, ohne daß großvolumige Kühlkörper erforderlich sind, die den gesamten Platzbedarf einer Leiterplattenanordnung im konkreten Anwendungsfall nachteilig vergrößern, und bei welcher die Herstellung des Kühlkörpers vereinfacht ist.

Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt durch die Merkmale des Patentanspruchs 1.

Bei der erfindungsgemäßen Leiterplattenanordnung ist die Kühlplatte mit mindestens einem Kühlkanal versehen, und zu beiden Seiten der Kühlplatte ist mindestens eine Leiterplatte angeordnet, so daß die Kühlplatte ein integrierter Bestandteil der gesamten Leiterplattenanordnung ist. Die Kühlplatte besteht aus einer auf einer isolierenden Trägerschicht angeordneten wärmeleitenden Kühleinschicht, und der Kühlkanal verläuft als einseitig offener Kanal in der Kühleinschicht und wird durch eine als Bestandteil zur gesamten Kühlplatte gehörende Isolierplatte abgedeckt, wodurch der Kühlkanal als geschlossener Kanal ausgebildet wird.

Von ihren äußeren Abmessungen her kann die Kühlplatte wie die Leiterplatten der Leiterplattenanordnung gestaltet sein, so daß die Kühlplatte einfach eine weitere Schicht bei einem Multi-Layer bildet. Dies ist

von besonderem Vorteil hinsichtlich der Gesamtabmessungen, denn im Vergleich zu großflächigen und großvolumigen Kühlkörpern fällt eine zusätzliche Schicht für die Kühlplatte kaum ins Gewicht.

Der Grundgedanke der Erfindung besteht darin, mit der Kühlplatte ein inneres und ein aktives Kühlsystem bei einer Leiterplattenanordnung zu bilden und die Wärme über die Kühlplatte und über die in der Kühlplatte verlaufenden Kühlkanäle bzw. über das darin befindliche Kühlmedium abzuführen. Dabei ist es denkbar, außerhalb der Leiterplattenanordnung, wo mehr Platz zur Verfügung steht, eine kleine Pumpe mit einem Wärmetauscher anzuordnen, um eine optimale Kühlung zu erzielen, und zwar mit einem deutlich besseren Wirkungsgrad als bei herkömmlichen Kühlkörpern.

Ein weiterer Vorteil besteht auch darin, daß sich die Kühlplatte über die gesamte Leiterplattenanordnung erstreckt und somit auch im gesamten Bereich eine Kühlung erfolgen kann. Dabei ist es ohne weiteres möglich, mehrere Kühlkanäle vorzusehen und diese insbesondere in den Bereichen anzuordnen, auf denen sich auf der Leiterplatte Leistungsbaulemente befinden, die besonders viel Wärme erzeugen. Durch einen schlangenlinienförmigen Verlauf kann man in Bereichen, in denen besonders viel Wärme anfällt, eine große Länge des Kühlkanals erreichen, der von dem Kühlmedium durchströmt wird, so daß dort auch besonders viel Wärme abgeführt werden kann.

Bei der Erfindung erfolgt eine aktive Kühlung in Form einer reinen Wärmeübertragungskühle durch die Verwendung von mit einem Kühlmedium gefüllten bzw. durchflossenen Kühlkanal. Der Wärmeübergang, also die Kühlung, ist dabei direkt an der verursachenden Quelle vorgesehen, wobei der Wärmeübergang zweistufig erfolgt. In der ersten Stufe wird die Wärme von der Kühlplatte und in der zweiten Stufe von dem Kühlmedium in den Kühlkanälen aufgenommen, die sich in der Kühlplatte erstrecken.

In vorteilhafter Weise wird die Kühlplatte in den Multi-Layer-Aufbau integriert, so daß die Kühlplatte einen integralen Bestandteil der Leiterplattenanordnung darstellt. Da bei einem Multi-Layer mit mehreren übereinander angeordneten Leiterplatten zwischen den einzelnen Leiterplatten bekanntlich jeweils eine Isolierplatte als Prepreg vorgesehen wird, wird im Grunde genommen dabei dieser Prepreg einfach durch die integrierte Kühleinschicht ersetzt, die aus der Kühlplatte besteht, die zu beiden Seiten eine Isolierplatte besitzt.

Ein besonderer Vorteil der Erfindung besteht auch noch darin, daß sich die Herstellung der Kühlplatte problemlos mit dem Herstellungsprozeß der Leiterplatte kombinieren läßt, denn aus fertigungstechnischer Sicht kann die Kühlplatte einfach als eine zu bearbeitende Leiterplatte angesehen werden. Hierbei befindet sich auf der Trägerschicht die aus wärmeleitendem Material bestehende Kühleinschicht, z. B. aus Kupfer. Durch einfaches Ätzen - wie bei der Herstellung von gedruckten

Leiterplatten - lassen sich die Kühlkanäle durch Entfernen von Kupfer an den betreffenden Stellen bilden, die dann noch einseitig offen sind. Anschließend wird auf die Kühlschicht eine Isolierplatte gelegt, so daß die offenen Kühlkanäle abgedeckt und zu geschlossenen Kühlkanälen werden. Als Isolierplatte kann dabei in an sich bekannter Weise das schon erwähnte Prepeg verwendet werden, was einen weiteren Vorteil der Erfindung bedeutet.

In einer weiteren zweckmäßigen Ausgestaltung der Erfindung bildet der Kühlkanal einen in sich geschlossenen Kanal. Diese Maßnahme läßt sich mit Erfolg anwenden, wenn nur geringe Kühlleistungen erforderlich sind.

In einer anderen vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung besitzt der mindestens eine Kühlkanal einen Eingang und einen Ausgang, und ferner ist eine externe Pumpe vorgesehen, mit welcher das Kühlmedium durch den Kühlkanal gefördert wird. Diese Maßnahme wird man bevorzugt bei größeren Kühlleistungen anwenden, und in einer weiteren zweckmäßigen Ausgestaltung der Erfindung ist dabei auch noch vorgesehen, das Kühlmedium mittels der Pumpe über einen Wärmetauscher zu führen. Dabei sind sowohl der Wärmetauscher als auch die Pumpe außerhalb der Leiterplattenanordnung angeordnet, so daß für die Leiterplattenanordnung selbst kein zusätzlicher Platzbedarf erforderlich ist.

Als Kühlmedium kann in zweckmäßiger Weise Luft, Wasser oder flüssiger Stickstoff verwendet werden, und das wärmeleitende Material der Kühlplatte läßt sich durch Kupfer oder durch Aluminium bilden.

Gemäß einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist mindestens eine Leiterbahn einer Leiterplatte teilweise großflächig als Kühlmetallschicht ausgebildet, die in einer wärmeleitenden Verbindung mit der wärmeleitenden Kühlschicht und/oder mit dem Kühlmedium steht.

Man kann also an der Stelle einer Leiterplatte, an der sich ein wärmeerzeugendes Bauelement befindet, die normalerweise schmal verlaufende Leiterbahn großflächig ausbilden, wobei diese große Fläche für sich dann eine Kühlmetallschicht bildet. Bereits dadurch wird direkt an dem Ort, an dem die Wärme erzeugt wird, eine gewisse Kühlung erreicht. Der Kühleffekt wird in vorteilhafter Weise dadurch unterstützt, daß diese Kühlmetallschicht in wärmeleitender Verbindung mit der wärmeleitenden Kühlschicht und/oder mit dem Kühlmedium der Kühlplatte steht. Zweckmäßigerweise wird man im Bereich dieser Kühlmetallschicht möglichst viele Kühlkanäle innerhalb der Kühlplatte anordnen, beispielsweise durch einen schlangenlinienförmigen Verlauf, um im Bereich der Kühlmetallschicht eine große Länge der Kühlkanäle zu erzielen. Normalerweise erfolgt der Wärmeübergang über die Isolierplatte zur Kühlplatte, wobei der Wärmewiderstand der Isolierplatte (Prepeg) beim Wärmetransport überwunden werden muß.

Durch die Kühlmetallschicht wird nun der Wärmeübergang zur Kühlplatte und zum Kühlmedium entscheidend verbessert, da die Kühlmetallschicht direkt in wärmeleitender Verbindung mit der Kühlplatte und dem Kühlmedium steht und der vergleichsweise große Wärmewiderstand der Isolierplatte nicht mehr überwunden zu werden braucht.

In zweckmäßiger Ausgestaltung der Erfindung wird die wärmeleitende Verbindung durch Bohrungen gebildet, welche die Leiterplatte und die Kühlplatte durchdringen, wobei die Innenwandungen der Bohrungen mit einem Wärmeleitmaterial versehen sind.

Die Erfindung befaßt sich auch noch mit einem Verfahren zur Herstellung einer Leiterplattenanordnung, wobei die Erfindung vorsieht, daß der Kühlkanal durch Ätzen einer metallischen Kühlschicht aus Kupfer oder Aluminium, die auf einer Trägerschicht angebracht ist, erzeugt wird.

Alternativ schlägt die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung einer Leiterplattenanordnung vor, bei welchem der Kühlkanal durch Prägung einer metallischen Kühlschicht aus Kupfer oder Aluminium, die auf einer Trägerschicht angeordnet ist, erzeugt wird.

Beide Verfahrensschritte stellen Maßnahmen dar, wie sie grundsätzlich bei der Herstellung gedruckter Leiterplatten zur Anwendung gelangen, so daß man die benötigte Kühlplatte integriert mit der Herstellung der gesamten Leiterplattenanordnung als Multi-Layer herstellen kann.

Anhand der in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiele wird die Erfindung nachfolgend näher erläutert. Es zeigen:

- Fig. 1 eine Querschnittsansicht eines Teiles einer Leiterplattenanordnung mit einer Kühlplatte,
- Fig. 2 eine perspektivische Ansicht einer Leiterplattenanordnung gemäß Fig. 1 in explodierter Darstellung,
- Fig. 3 eine Draufsicht auf eine Leiterplattenanordnung mit zwei Kühlmetallschichten,
- Fig. 4 eine Teil-Querschnittsansicht der Anordnung gemäß Fig. 3, und
- Fig. 5 eine schematische Darstellung einer Leiterplattenanordnung mit einem externen Wärmetauscher.

Gemäß Fig. 1 und 2 umfaßt die Leiterplattenanordnung 10 eine Leiterplatte 12 mit einem Träger 14. Der Träger 14 ist beidseitig mit elektrischen Leiterbahnen 16 bedruckt, wobei sich oben die Bestückungsseite befindet.

An die Leiterplatte 12 schließt sich nach unten hin als Isolierplatte 20 ein Prepeg an, und darunter befindet sich eine Kühlschicht 22 aus Kupfer, welches als

Kupferschicht auf einer Trägerschicht 26 angeordnet ist.

Innerhalb der Kühlschicht 22 erstreckt sich ein Kühlkanal 24. Die Herstellung des Kühlkanals 24 kann in einfacher Weise durch Ätzen erfolgen, also durch Entfernen des Kupfers im Bereich des Kühlkanals 24. Es ist auch möglich, den Kühlkanal 24 in einer Prägetechnik durch Prägen herzustellen. Dabei ist der Kühlkanal 24 zunächst nach oben hin offen. Durch die Isolierplatte 20 wird der Kühlkanal 24 im fertigen Zustand der gesamten Leiterplattenanordnung 10 abgedeckt und zu einem geschlossenen Kühlkanal. Die Isolierplatte 20 läßt sich in vorteilhafter Weise in Form eines Prepreg zum Verbinden der Leiterplatte 14 mit der Kühlschicht 22 verwenden. Die Kühlschicht 22 mit dem Kühlkanal 24 sowie die als Isolierschicht ausgebildete Trägerschicht 26 und die Isolierplatte 20 bilden insgesamt eine Kühlplatte 18 innerhalb der Leiterplattenanordnung 10.

An die Kühlplatte 18 bzw. an die Trägerschicht 26 schließen sich als Isolierplatte ein Prepreg 28 sowie eine Leiterplatte 30 mit einem Träger 32 an. Der Träger 32 ist oben und unten mit elektrischen Leiterbahnen 34 versehen, wobei die untere Seite des Trägers 32 die Lötseite bildet. Da die Trägerschicht 26 bereits als Isolierplatte ausgebildet ist, ist es auch möglich auf die weitere Isolierplatte in Form des Prepregs 28 zu verzichten, denn die Trägerschicht 26 kann die Funktion des Prepregs 28 mit übernehmen.

Fig. 3 zeigt in einer Draufsicht eine Leiterplatte 10, auf deren Träger 14 zwei Leiterbahnen 16 in Teilbereichen großflächig ausgebildet sind und eine Kühlmetallschicht 36 und eine weitere Kühlmetallschicht 38 bilden. In der Leiterplatte 10 befinden sich zwei die Kühlplatte 18 durchdringende Bohrungen, die für die Kühlkanäle 24 einen Eingang 44 und einen Ausgang 46 bilden, um mittels einer hier nicht dargestellten externen Pumpe einen Kreislauf für ein Kühlmedium durch die Kühlkanäle 24 herzustellen (vgl. auch Fig. 5).

Im Bereich der Kühlmetallschichten 36 und 38 verlaufen die Kühlkanäle 24 derart, daß sich dort eine möglichst große Länge der Kühlkanäle und damit eine möglichst große Verweildauer des Kühlmediums im Bereich der Kühlmetallschichten 36 und 38 ergibt. So erstreckt sich der Kühlkanal 24 im Bereich der Kühlmetallschicht 36 schlangenlinienförmig. Dadurch wird eine besonders gute Wärmeableitung erreicht.

Die Kühlmetallschichten 36 und 38 stehen über Bohrungen 40 in wärmeleitender Verbindung mit der Kühlschicht 22, wie dies anhand der Teil-Querschnittsansicht gemäß Fig. 4 für die Kühlmetallschicht 38 verdeutlicht ist. Die Innenwandungen der Bohrungen 40 sind mit einem Wärmeleitmaterial 42 nach Art einer Innenhülse versehen, wodurch eine Durchkontaktierung von der Kühlmetallschicht 38 zur Kühlschicht 22 hergestellt wird.

Während normalerweise beim Wärmeübergang zur Kühlschicht 22 der Wärmewiderstand der Isolierplatte 20 überwunden werden muß, wird in Fig. 3 die von den

Kühlmetallschichten 36 und 38 aufgenommene Wärme direkt über die wärmeleitenden Verbindungen in Form der Bohrungen 40 zur Kühlschicht 22 geführt.

Die schematische Darstellung in Fig. 5 zeigt eine Leiterplattenanordnung 10, bei welcher der Eingang 44 und der Ausgang 46 der Kühlschicht 18 über Leitungen 48 mit einem externen Wärmetauscher 50 mit einer Pumpe verbunden sind, um ein Kühlmedium durch die Kühlkanäle 24 zu fördern. Selbstverständlich können gleichzeitig auch mehrere Leiterplattenanordnungen bzw. mehrere Kühlschichten an den Wärmetauscher 50 angeschlossen werden. Der dabei erzielte Wirkungsgrad für die Kühlung liegt um ein Vielfaches höher als bei Verwendung von herkömmlichen großvolumigen und unhandlichen Kühlkörpern.

Patentansprüche

1. Leiterplattenanordnung (Multi-Layer) (10) mit mindestens zwei Leiterplatten (12; 30), die einseitig oder beidseitig mit elektrischen Leiterbahnen (16; 34) versehen und mit Wärme erzeugenden Bauelementen bestückt sind, mit mindestens einer Kühlplatte (18), die mit mindestens einem Kühlkanal (24) versehen ist, wobei zu beiden Seiten der Kühlplatte (18) mindestens eine Leiterplatte (12; 30) angeordnet ist, wobei die Kühlplatte (18) eine auf einer als Isolierschicht ausgebildeten Trägerschicht (26) angeordnete wärmeleitende Kühlschicht (22) umfaßt, und wobei der Kühlkanal (24) als einseitig offener Kanal in der Kühlschicht (22) verläuft und durch eine zur Kühlplatte (18) gehörende Isolierplatte (20) abgedeckt ist.
2. Leiterplattenanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Kühlkanal (24) einen in sich geschlossenen Kanal bildet.
3. Leiterplattenanordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Kühlkanal (24) einen Eingang (44) und einen Ausgang (46) besitzt, und daß eine externe Pumpe vorgesehen ist, mit welcher ein Kühlmedium durch den Kühlkanal (24) gefördert wird.
4. Leiterplattenanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 - 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Kühlmedium mittels der Pumpe einen Wärmeaustauscher (50) durchströmt.
5. Leiterplattenanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 - 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Kühlmedium durch Luft, Wasser oder flüssigen Stickstoff gebildet ist.
6. Leiterplattenanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 - 5, dadurch gekennzeichnet, daß das wärmeleitende Material (22) der

Kühlplatte (18) durch Kupfer gebildet ist.

7. Leiterplattenanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 - 5, dadurch gekennzeichnet, daß das wärmeleitende Material (22) der Kühlplatte (18) durch Aluminium gebildet ist. 5
8. Leiterplattenanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 - 7, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens eine Leiterbahn (16; 34) einer Leiterplatte (12; 30) teilweise großflächig als Kühlmetallschicht (36, 38) ausgebildet ist, und daß die Kühlmetallschicht (36, 38) in wärmeleitender Verbindung mit der wärmeleitenden Kühlenschicht (22) und/oder mit dem Kühlmedium steht. 10
15
9. Leiterplattenanordnung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß die wärmeleitende Verbindung durch die Leiterplatte (12) und die Kühlplatte (18) durchdringende Bohrungen (40) gebildet ist, deren Innenwandungen mit einem Wärmeleitmaterial (42) versehen sind. 20
10. Verfahren zur Herstellung einer Leiterplattenanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 - 9, dadurch gekennzeichnet, daß der Kühlkanal (24) durch Ätzen einer metallischen Kühlenschicht (22) aus Kupfer oder Aluminium, die auf einer Trägerschicht (26) angebracht ist, erzeugt wird. 25
30
11. Verfahren zur Herstellung einer Leiterplattenanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 - 9, dadurch gekennzeichnet, daß der Kühlkanal (24) durch Prägung einer metallischen Kühlenschicht (22) aus Kupfer oder Aluminium, die auf einer Trägerschicht (26) angeordnet ist, erzeugt wird. 35

40

45

50

55

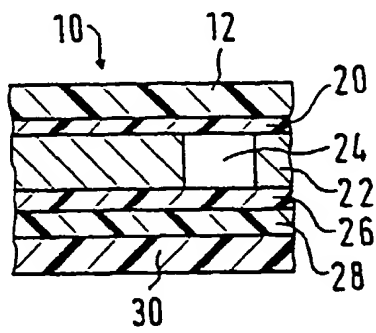


Fig. 1

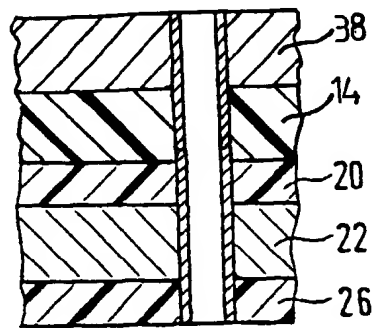


Fig. 4

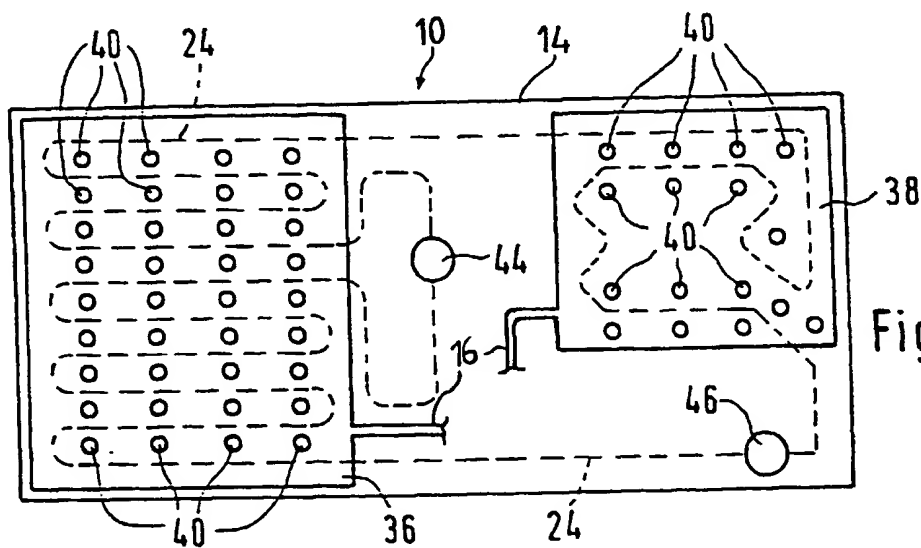


Fig. 3

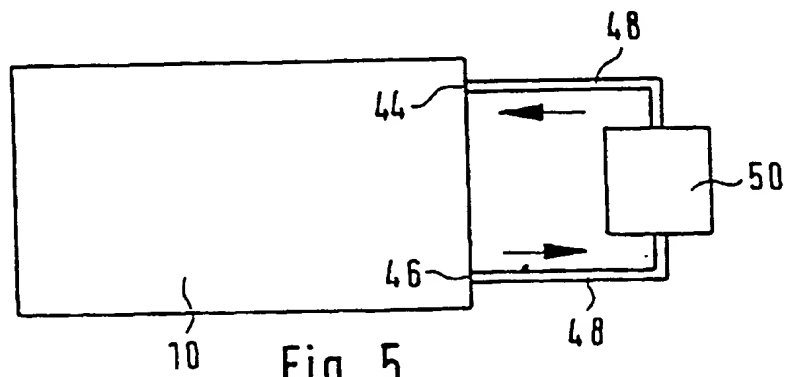


Fig. 5

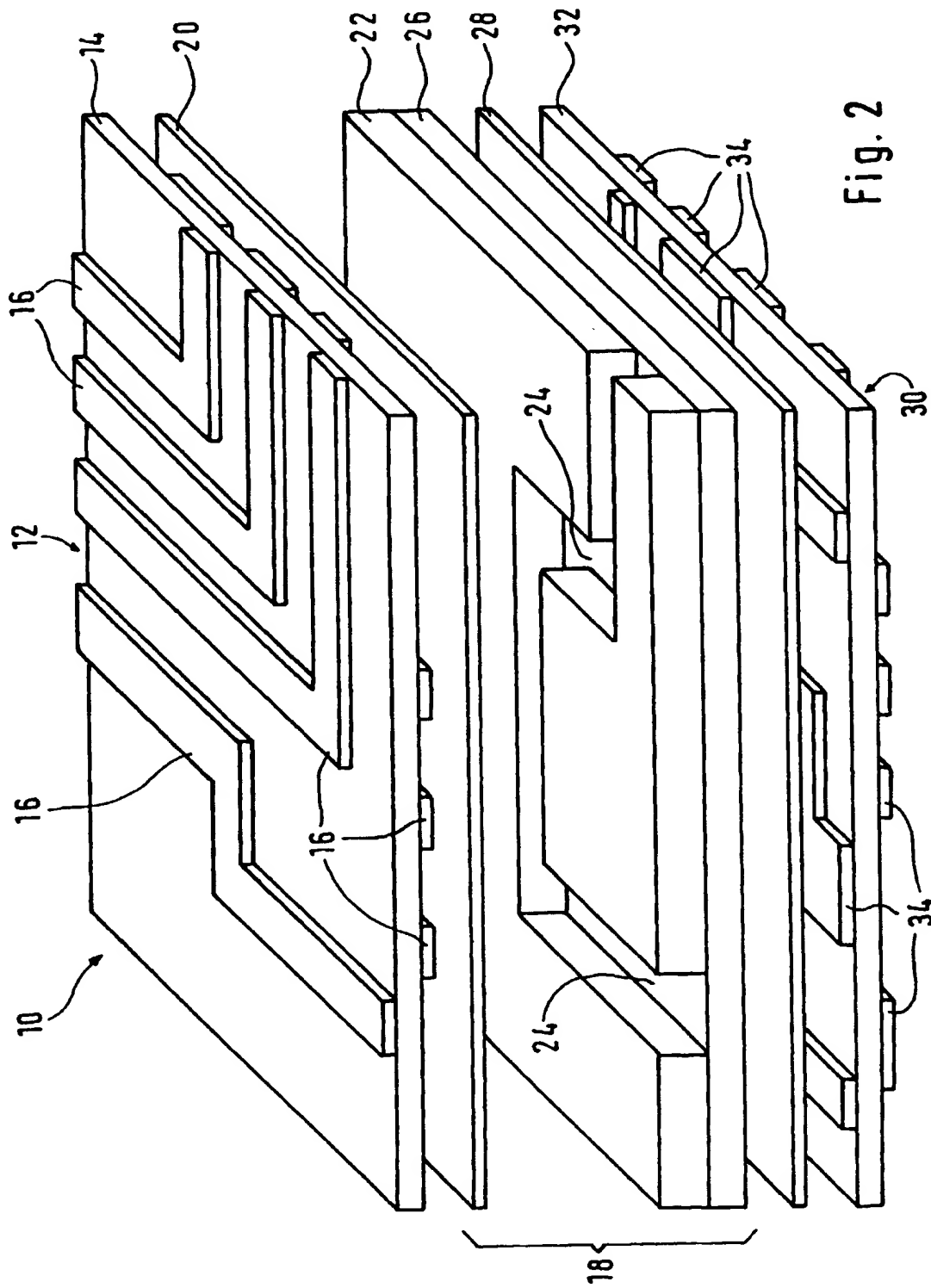


Fig. 2